



PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

NEO 3400

Массовое
производство

Удаление
резиста/декам

Очистка после
имплантации

Травление



When plasma matters



PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

NEO 3400



Платформа NEO 3400 является одним из последних пополнений в линейке установок плазменной обработки, озонения и зачистки пластин от компании Trymax Semiconductor Equipment. Система готова к использованию для серийного производства и может быть адаптирована под любую скорость производства и любой бюджет. NEO 3000 комбинируется с любым из существующих технологических модулей Trymax NEO для обработки подложек диаметром до 300 мм. Компактный размер и модульный дизайн позволяют гибко конфигурировать систему в зависимости от ваших потребностей.

Система может быть использована как бридж система между пластинами 200 мм и 300 мм диаметром.

Характеристики

- 200/300 мм размер п/п пластин/подложек
- 4 загрузочных порта
- Четырехосевое подающее устройство с двумя манипуляторами
- 2 или 4 рабочих камеры
 - СВЧ (2,45 ГГц)
 - ВЧ-смещение (13,56 МГц)
 - Двойной источник (СВЧ, ВЧ-смещение)
- Механическая производительность > 300 п/п пластин в час
- Компактное основание
- Низкие эксплуатационные расходы
- Система связи с цифровым управлением (Devicenet-Ethernet)
- Промышленный ПК на базе Windows

Применение

- Удаление резиста с большой площади
- Пост-обработка после лазерной десорбции/ионизации
- Удаление непроявленного резиста
- Удаление полимера
- Удаление резиста после высокодозной ионной имплантации
- Травление нитрида кремния/карбида кремния
- Травление TaSi
- МЭМС
- Корпусирование и тестирование (PR, PI, VCB, PBO)
- BAW/SAW ВЧ-фильтры

Стандарты соответствия

- SEMI S2-01
- SEMI S8-01
- CE EU-RoHs
- UL (опционально)



Официальный представитель в России



«ТБС», Москва, Киевская 7

Телефон: +7 (495) 287 8577
+7 (495) 783 0284

E-mail: info@tbs-semi.ru
Web: www.tbs-semi.ru

www.trymax-semiconductor.com